PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-049613

(43) Date of publication of application: 23.03.1982

(51)Int.CI.

C08G 59/68 C08F 4/00 C08G 8/00 C08G 63/10 C08G 65/02

(21)Application number: 55-124345

(71)Applicant : ASAHI DENKA KOGYO KK

(22)Date of filing:

08.09.1980

(72)Inventor: MORIO KAZUHIKO

MURASE HISASHI

(54) THERMOSETTING RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: The titled composition suitable as an adhesive, quickly curable under heating, comprising a cationic polymerizable organic substance and a phosphorus atom-containing Lewis acid or a phosphonium salt of a strong acid in a specific ratio.

CONSTITUTION: (A) 100Pts.wt. cationic polymerizable organic substance (e.g., epoxy resin, etc.) is blended with (B) 0.1W15pts.wt. Lewis acid consisting of a cation having one or more phosphorus atoms and no aromatic group and a nonnucleophilic aninon (e.g., BF4-, etc.) shown by the formula MQm (M is B, P, Sb, etc.; Q is halogen, e.g., F, etc.; m is 1W6) or phosphonium salt of a strong acid, and the blend is heated to give a cured material. The addition of (C) 0.1W25pts.wt. curing accelerator selected from the group consisting of a nucleophilic reagnet (e.g., thiophenol, etc.), an organometallic compound (e.g., copper, etc.) and a metallic salt of an organic acid can further shorten the curing time.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57-49613

Int. Cl. C	識別記 号	庁内整理番号	❸公開 昭和57年(1982)3月23日
C 08 G 59/68		7342—4 J	
C 08 F 4/00		7823—4 J	発明の数 2
C 08 G 8/00		6946—4 J	審査請求 未請求
63/10		7919—4 Ј	
65/02		6911—4 J	(全 6 頁)
		•	

③熱硬化性組成物

②特

願 昭55-124345

②出

願 昭55(1980)9月8日

70発 明 者 森尾和彦

東京都荒川区東尾久7丁目2番 35号旭電化工業株式会社内 70発 明 者 村瀬久

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号旭電化工業株式会社内

切出 願 人 旭電化工業株式会社

東京都荒川区東尾久7丁目2番

35号

個代 理 人 弁理士 古谷馨

38 4R 3

1. 発明の名称

熱硬化性組成物

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. (1) 陽イオン重合性有機物質と、
 - (2) リン原子を1個以上有するルイス酸又は強酸のホスホニウム塩

とを含有する熱硬化性組成物。

- 2. ホスホニウム塩が、リン原子を1個有し芳香族基を有したい陽イオンと、非水核性陰イオンとから構成されているルイス酸又は強酸のホスホニウム塩である特許請求の範囲銀1 項記載の熱硬化性組成物。
- 3. ホスホニウム塩が、リン原子を2個以上有する陽イオンと非求核性陰イオンとから構成されているルイス酸又は強酸のホスホニウム塩である特許請求の範囲第1項記載の無硬化性組成物。
- 4. 非求核性陥イオンが一般式 MQm (式中 M は B, P, 8b, As, Fe, Al, Cr, Mn, Ti,

Odから選ばれる原子、 Q はハロゲン原子、 m は 1 ~ 6 の数)で示される強イオンである特許界の範囲第 2 項叉は第 5 項記載の熱硬化性組成物。

- 5. ハロゲン原子がフッ案である特許請求の範囲第4項記載の熱硬化性組成物。
- 6. (1) 勝イオン遺合性有機物質 1 0 0 電量部と、(2) リン原子を 1 個以上有するルイス膜又は強酸のホスホニウム塩 0.1~ 1 5 重量部とを含有する特許請求の範囲第 1~ 5 項記載の熱硬化性組成物。
- 湯イオン電合性有機物質がエポキシ樹脂である特許請求の範囲第1~6項記載の熱硬化性組成物。
- 8. (1) 陽イオン電合性有機物質と、
- (2) リン原子を1個以上有するルイス酸又は強酸のホスホニウム塩と、
 - (5) 親核性試薬、有機金属化合物及び有機 酸の金属塩からなる群から選ばれた硬化 促機器

- 2 -

とを含有する熱硬化性組成物。

- 9. ホスホニウム塩が、リン原子を 1 個有し芳香族器を有しない陽イオンと、非求核性陰イオンとから構成されているルイス徴又は強酸のホスホニウム塩である特許請求の範囲第 8 項記載の熱硬化性組成物。
- 10. ホスホニウム塩が、リン原子を 2 個以上有する陽イオンと、非求核性陰イオンとから構成されているルイス酸又は強酸のホスホニウム塩である特許請求の範囲第 8 項配数の熱硬化性組成物。
- 11. 非求核性陰イオンが一般式 MQm(式中 M は B, P, Sb, Ae, Pe, A1, Cr, Mn, Ti, Od から選ばれる原子、 Q はハロゲン原子、 m は 1 ~ 6 の数)で示される陰イオンである特許界の範囲第9項又は第10項配戦の熱硬化性組成物。
- 12. ハロゲン原子がフッ素である特許請求の範囲第11項記載の熱硬化性組成物。
- 15. (1) 陽イオン食合性有機物質 100 食量部と、

- 5 -

以内に硬化するものが理想的であるが、現在ま で多くの場合二波方式に依らざるを得なかつた。 また潜在性の硬化触媒としてよく知られている プミンー BP3 錯体(たとえばモノエチルアミン BF3) は加熱により硬化を開始するが、そのた めには高温に1~8時間保つととが必要である。 さらに改良型としてホワイト (W. B. White) め 米闌特所第 8,5 6 5,8 6 1 号にはアミシー PB5 錯 体が述べられているが、同様に高温での硬化性 は十分であるとは言えない。ところで、クリヴ エロ (J. V. Orivello) の日本特許公開公報昭和 54年 102394号にはある程の芳香族ホスホ ニウム塩は適当な還元剤の存在下、高温で比較 的速やかにエポキシ樹脂を硬化せしめることが 可能であることが記述されている。しかるに、 これらの芳香族ホスホニウム塩は安定性には優 れるが、合成が容易でないばかりか、硬化に際 してかなりの高温を要するのが一般的である。

本発明者らは、先の出願において芳香族置換スルホニウム塩と脂肪族置換スルホニウム塩の

- (2) リン原子を 1 個以上有するルイス酸又 は強酸のホスホニウム塩 0.1 ~ 1 5 質量 部と、
- (5) 親核性試察、有機金属化合物及び有機 酸の金属塩からなる群から選ばれる硬化 促進剤 0.1 ~ 2.5 重観部

- 14. 関イオン電合性有機物質がエポキシ樹脂で ある特許請求の範囲第8~1 3 項記載の熱硬 化性組成物。
- 8. 発明の詳細な説明

本発明は熱硬化性組成物に関する。詳しくは、本発明はカチオン電台可能な有機物質を短時間に電台し、良好な硬化物を得るための潜在性に優れた熱硬化性組成物に関する。

カチオン 重合触媒、とりわけエポキシ樹脂の 硬化触媒は現在まで数多く知られている。 かかるエポキシ樹脂触媒は、常温での可健時間が長 く、しかも加熱すると短時間、具体的には数分

- 4 -

安定性と触媒能の相逢について示したが、一般的にオニウム塩はその陽イオン性原子に隣接して芳香族體検塞を有すると、熱的安定性は増加するが、逆にカチオン重合の加熱型触媒としての反応性は低下することがいえる。

さらに脂肪族ホスホニウム塩の場合は分子設計の許容範囲が大きく、そのために置換器を変化させて比較的自由に活性温度を選択することが可能である。

即ち、本発明は、(1)陽イオン賞合性有機物質と、(2)リン原子を1個以上有するルイス酸又は

特開昭57~49613 (3)

強酸のホスホニウム塩とを含有する熱硬化性組成物、あるいは(1) 勝イオン電合性有機物質と、(2) リン原子を1個以上有するルイス酸又は強酸のホスホニウム塩と、(3) 親核性試薬、有機会異化合物及び有機酸の金属塩からなる群から選ばれた硬化促進剤とを含有する熱硬化性組成物を担似するものである。上記リン原子とはカチオン性リン原子であるものをいう。

本発明に用いられる附イオン重合性有機物質(1)としては、酸重合性又は酸硬化性有機物質、とりわけエボキシ樹脂が好ましく用いられる。

本発明に使用されるエポキシ樹脂とは従来公 知の芳香族エポキシ樹脂、脂類族エポキシ樹脂、脂別族エポキシ樹脂が挙げられる。ここで芳香族エポキシ樹脂として特に好ましいものは、少なくとも1個の芳香族核を有する多価フェノール又はそのアルキサイド付加体のポリンシルエーテルでもつて、例えばピスフェノールム又はそのアルキレンオキサイド付加体とエピクロルヒドリンとの反応によつて製造さ

- 7 -

本発明の陽イオン官合性有機物質としてはこれらの労者族エポキン樹脂、脂漿族エポキン樹脂 脂又は脂肪族エポキン樹脂を単独でも使用する ことができるが、所望の性能に応じて適当に配合することが望ましい。

本発明の勝イオン重合性有機物質として使用可能なその他の酸重合性または酸硬化性有機物質としてはエピスルフィド樹脂、環状エーテル、

さらに脂肪族エポキシ樹脂として特に好ましいものは脂肪族多価アルコール又はそのアルキレンオキサイド付加物のポリグリシジルエーテルがあり、 その代表例としては、 1 , 6 - ヘキサンジオールのシグリンジルエーテル、 グリセリンのトリグリンジルエーテル、ポリブログリコールのジグリンジルエーテル、ポリブロ

- 8 -

ラクトン、ピニルエーテル、フエノール/ホルムアルデヒド樹脂等の有機物質が挙げられる。 かかる陽イオン電合性有機物質は単独或いは二 種以上の混合物として使用できる。

本発明に用いられるホスホニウム塩(2)としては、リン原子を1個有し芳香族芸を有しない間イオンと、非求核性陰イオンとから構成されているルイス酸又は強酸のホスホニウム塩(2-2)等が好ましく用いられる。

上記非求核性陰イオンとして好ましいものは 一般式 MQm (I)

(式中Mは、B,P,8b,As,Fe,Al,Or,Mn,Ti,Cdから選ばれる原子、Qはハログン原子、ロは1~6の数)

で示される陰イオンであり、例えば、テトラフ ルオロポレート(BP4⁻)、ヘキサフルオロホス フエート(PPō)、ヘキサフルオロアンチモネー ト(8086⁻)、ヘキサクロロアンチモネート (80016⁻)、ヘキサフルオロアルセネート(AsP6⁻) 等が挙げられる。

さらに一般式 MQm-10H (II) (式中M, Q, nは上記に同じ)で示される除イオンも用いることができる。さらに他の非求核性除イオンとしては過塩素酸イオン (Clou)、トリフルオロメチル亜硫酸イオン (OF5805)、フルオロスルホン酸除イオン、トリニトロベンゼンスルホン酸除イオン等が挙げられる。

上記ホスホニウム塩(2-1)としては一般式

$$\begin{bmatrix} R_2 \\ R_1 - P - R_4 \\ R_3 \end{bmatrix}^+ (X)^-$$

(式中 R1 , R2 , R3 , R4は同一又は相異なる置換又は非置換の脂肪族基で R1 ~ R4 の少なくとも 1 つはリン原子に隣接する Bp³ 混成の炭素原子を有する。 R1 ~ R4 のうち 2 つが P を含む寝を形成していてもよく、又 R1 ~ R4 は不飽和結

-11-

Ph3P CH200H2P Ph3 · 2 PF6
Ph3P CH200H2P Ph3 · 2 PF6

笄の化合物を挙げるととができる。

とりしたホスホニウム塩は比較的容易に合成され、例えば対応する第三ホスフィンをアルキルハライドと反応させハロゲン陰イオンを有するスルホニウム塩を合成し、しかる後に HMQm, NaMQm, KMQm, NH4MQm (M, Q, mは上配に同じ)

特開昭57-49613(4)

合、アルコキシ海、ニトロ海、シアノ海、水酸 苺、カルポキシル基、ハログン苺、エステル基、 ケトン苺、エーテル菇等の官能苺を含むことが できる。又は非水核性陸イオンである。)

で示される一群の化合物を挙げるととができる。

上記一般式[11]で示される化合物としては

(OH3 OH2 OH2 OH2) # P+ . PF6

(OH3 OH2 OH2 OH2 + P+ OH2 CH = OH2 · ABF6

(CH 3 CH 2 CH 2 OH 2) T P OH 2 CH . AB F6

(OH3 OH2 CH2 OH2 +3 P+ OH2 OO2 O2 H5 · PF6

(CH3 CH2 CH2 +3 P - CH2 ON - ABF6

(nC8H17) 3 P CH2CN - 8 bF6

(CH3CH2CH2OH2) , P-002H · ABF6

等を挙げるととができる。

さらにホスホニウム塩 (2-2) としては

- 12-

等の試楽により陰イオン交換を実施しても得られるし、あるいは直接的に第三ホスフィンにトリエチルオキソニウムテトラフルオロボレートのごともメールワイン試楽を反応させることにより好収率で合成することが可能である。

本発明に用いられる硬化促進剤(3)としてはチオフェノール、ペンタクロロチオフェノール等のチオフェノール及びその酵導体、チオサリチル酸安息香酸、酢酸、ステアリン酸、クェン酸等の塩基性の弱い親核性試薬、 Ou , Co , 8n をどの有機金属化合物又はこれらの金属と有機酸との塩が用いられる。

本発明の熱硬化性組成物は陽イオン重合性有機物質(1) 1 0 0 重量部に対して 0, 1 乃至 1 5 重量部、より好ましくは 1 乃至 1 0 重量部のホスホニウム塩(2)を用いることが好ましい。かかる組成物は一般に 25 での粘度で 1 乃至 1,000,000センチボイズの液状もしくは粉末または固体の状態であるが、 5 0 で乃至 2 5 0 でに加熱するとにより、 3 0 分以内に硬化反応が超こり非

特開船 57-49613(5)

粘着性の硬化物を得ることができる。さらに第三の成分として 0.1 乃至 2 5 重量部の硬化促進剤(3)を並用することにより、硬化時間を短縮することができる。

本発明の組成物には、さらにカチオン重合を 損なわない範囲で稀釈のための溶剤や改質のための非反応性の樹脂やブレポリマーを配合する ことができる。また例えば電気特性を改良する 目的などのため有機カルボン酸や酸無水物を使 用したり、あるいはゴム弾性をもたせるなどの 目的でポリオールを混合するのもよい。

本発明の組成物はさらに顔料、 染料、 増量剤、 難燃剤、 静電防止剤、 ゲル化防止剤、 密着性改 良剤、 流れ調整剤、 界面活性剤などと混合して も用いられる。とれらの添加剤の量は機能と硬 化性のパランスで決められるが、 こうした組成 物は金属、 木材、 ゴム、 ブラスチックス、 ガラ ス、 セラミック製品等に使用することができる。 本発明の具体的な用途としては、 例えば保護、 ッヤ出しワニス、インキ、接着剤、 絶縁材料、

- 15-

れ 1 5 0 ℃ に加熱したととろ約 1 0 分で非粘着性の硬化物が得られた。

奖施例 2

実施例1に準じ、さらに5 重量部の安息香酸またはクエン酸を添加し150℃で加熱したところ硬化性は改良され、いずれも約2.5分以内に硬質の固型物質が得られた。また3重量部のペンタクロロチオフエノールを促進剤として使用した場合には約5分で周型物を与えた。 実施例5

実施例1に準じ、さらに5 電量部の安息香酸館(II)を添加し、170℃で加熱したところ約1分でゲル化が超こり固状物が得られた。 実施例4

製造例1で得られたホスホニウム塩5 重量部と Ep-4100(ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、旭電化工業製) 100重量部を混合し、約19を2 M容のガラス製サンブルビンにとり190でで加熱したところ約90分でゲル化が起こり、固状物質が得られた。

成形材料、注型材料、ガラス機能含浸テープな どを挙げるととができる。

以下契施例によつて本発明の有効性を更に具体的に説明するが本発明はその要旨を越えない 限り以下の契施例に割約されるものではない。 製油例 1

トリプチルホスフイン128とクロルアセトニトリル59をベンゼン36配中3時間加熱遺流した後、ベンゼンを留去すると黄色油状物質が得られた。この油状物質を乾燥エーテル20mlにて2回洗浄すると間状物質179が得られた。この間状物質を水100配に溶解し、六フン化に素酸カリ1488を含む水溶液200配と混合した。混合液からただちに白色の沈酸249が析出した。

學施例 1

- 16'-

突施例 5

実施例も

実施例4に準じさらにステアリン酸鋼3重量部を加え190℃に加熱したところ約5分でゲル化が起こり固状物質が得られた。

実施例 7

実施例 4 に準じさらに、安息香酸明 5 重量部を加え 1 9 0 でに加熱したところ約 5 分でゲル化が起こり固状物質が得られた。

実施例 8

製造例 1 で得られたホスホニウム塩 5 重量部と OY-179 10 重量部、 BP-4100 90 重量部を 温合し、 1 9 0 でに加熱したところ約 1 0 分でゲル化が起こり固状物質が得られた。

実施例?

実施例 8 に準じ、さらに安息香酸またはクエン酸 5 重量部を添加し1 9 0 ℃に加熱したとこ

ろ、いずれも約1分で硬化が超とり固状物質が 得られた。

突焰例10

安施例 1 1

実施例 8 に準じさらにステアリン酸鋼 3 重量部を加え 1 9 0 でに加熱したところ約 2 分でゲル化が起こり固状物質が得られた。

突施例12·

シアノメチルトリプチルホスホニウムへキサフルオロアンチモネート 5 重量部と OY - 1 7 9 1 0 0 重量部を 1 5 0 ℃ に加熱したところ 5 分で非粘着性の硬化物が得られた。

实施例 1 3

実施例 1 2 に準じさらに安息香酸 5 重量部を加え 1 5 0 でに加熱したところ 1 分以内に硬化が起こり、硬質の固型物が得られた。

奥施例14

- 19 -

た。また実施例 1 2 の配合物を同様の方法で測定したところ 1 2 5 ℃で発熱を開始し 1 3 9 ~ 1 5 0 ℃の間で発熱が最高となつた。

特許出顧人 旭馆化工業株式会社 代 型 人 古 谷 縣

特開昭57-49613(6)

シアノメチルトリプチルホスホニウムヘキサフルオロホスフェート 5 重量部、ペンタクロロチオフエノール 5 重量部及び OY -- 1 7 9 1 0 0 電量部を混合し、1 9 0 ℃に加熱したところ約2分で硬質の固型物が得られた。

突 舱 例 1 5

トリプチルアリルホスホニウムへキサフルオロホスフェート 5 貫景部と 0Y - 1 7 9 1 0 0 質景部を混合し、 1 9 0 ℃に加熱したところ約 50分でゲル化が起こり、固状物質が得られた。

実施例16

トリプチルカルポエトキシメチルホスホニウムへキサフルオロアンチモネート 3 貨量部をCY -179 100 重量部と混合し170 でに加熱したところ約5分でグル化が起こり、固塑物が得られた。

突施例 1 7

実施例 1 の配合物を 5 マアルミバンの上にとり 5.0 で/分のスピードで昇温したところ 148 でで発熱を開始し1 7 5 でで発熱は最高に達し

- 20 -